

NAR Labs 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		文件編號 DOCUMENT NO.	S3-NL05
		總頁數 TOTAL PAGE	共 2 頁
文件名稱 TITLE	儀器設備作業標準(CF-M13 應力量測儀)		

機台名稱： 應力量測儀

機台編號： CF-M13

制訂部門： 微影光罩組

制訂日期： 2006/08/15

文件制修訂記錄

NO	發行日期	修訂申請書編號	制修訂內容	修訂頁次	版本
01	2006/09/01	-----	制定初版	-----	01
02	2007/09/20	96-DC10	文件名稱異動	全部	1.2
03	2008/10/29	97-DC30	文件內文修訂	P.2	1.3
04	2009/03/01	98-DC01	制訂部門名稱異動	P.0	1.4
05	2013/07/01	102-DC09	修改表首 logo 及制訂部門名稱 修改	All	02
06					
07					
08					

核 准	審 查	制 訂

NAR Labs 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-M13 應力量測儀)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	02	PAGE	第 1 / 2 頁

一、目的：

定義 Stress 應力量測儀操作規範，以確保操作品質。

二、範圍：

適用 Stress 應力量測儀。

三、權責：

1. 組織權責：工程師負責制定及修改規範。
2. 執行人員資格：經過 Stress 應力量測儀考核通過之人員。

四、名詞定義：

無。

五、相關文件：

TENCOR FLX-2320 MANUAL
.....

六、標準作業程序：

1. 刷卡開機。
2. 按 Main Switch 鈕及 Laser Key switch 鈕開啟機台。
3. 打開機台電腦。
4. 從 Main Menu 視窗中選擇 4 吋或 6 吋晶圓 Process Program ，然後按 ENTER。
5. 將基板晶圓正面朝上，放入量測平台。
6. 先進行薄膜成長前的應力量測，從 Main Menu 視窗中選擇 Stress Measurement 及 First 選項。
7. 輸入 filename 和 ID，然後按 ENTER 執行量測動作。
8. 量測結束，按 ENTER 重新顯示 Main Menu 視窗。
9. 薄膜成長後，再次將晶圓正面朝上，放入量測平台。
10. 從 Main Menu 視窗中選擇 Stress Measurement 及 Single Stress 選項。
11. 輸入第一次基板晶圓所用的 filename 和 ID。
12. 輸入薄膜厚度(單位 Å)然後按 ENTER，執行應力量測動作。
13. 量測結束，按 ENTER 重新顯示 Main Menu 視窗，並顯示應力量測值。

NAR Labs 國家實驗研究院 國家奈米元件實驗室		DOCUMENT NO. : S3-NL05	TITLE : 儀器設備作業標準 (CF-M13 應力量測儀)		
ISSUE DATE	2013/07/01	REVISION	02	PAGE	第 2 / 2 頁

14. 按 ESC 鈕關閉應力值視窗。
15. 結束量測動作時壓 Main Switch 鈕及 Laser Key switch 鈕，關閉機台。
16. 關掉電腦。
17. 刷卡關機。

七、應用表單及附件：

1. 設備考核表 S4-NL01A
2. 設備點檢表 S4-NL01B
3. 設備使用記錄表 S4-NL01C
4. 異常及矯正預防處理單 S4-NL02A
5. 儀器設備管理卡 S4-NL04B